

## プリント基板加工装置

レーザーやドリルで、セラミック基板、ガラスエポキシ基板上に配線加工や穴あけ加工を行い、プリント基板を試作する装置

### 【型式】

レーザー基板加工機 ProtoLaser S(LPKF 社製)  
ミリング基板加工機 ProtoMat43A(LPKF 社製)  
電子回路 CAD Opser(ユニクラフト社製)

### 【仕様】

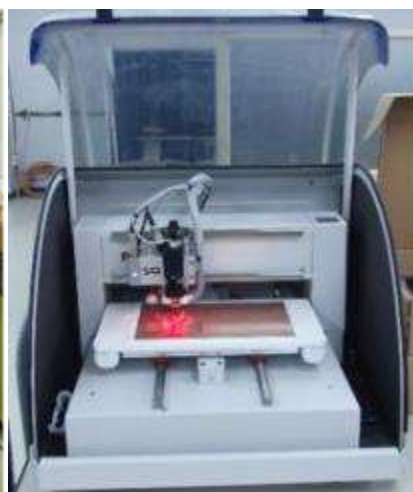
レーザー基板加工機 最大基板寸法：305×229×10mm 最小ライン幅：50 $\mu$ m  
ミリング基板加工機 最大基板寸法：305×229×14mm 最小ライン幅：100 $\mu$ m

### 【設置年度】

2013 年度（平成 25 年度）



レーザー基板加工機



ミリング基板加工機

○ 設備・機器に関してのご質問，設備利用の手続き等は，[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和 4 年 7 月 12 日